

Topnik RF800

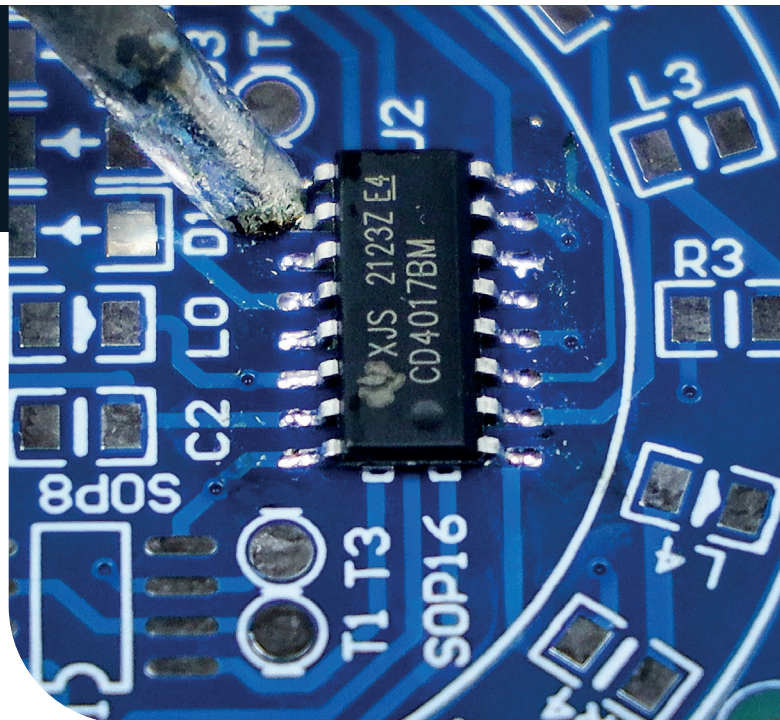
Niezastąpione rozwiązanie dla precyzyjnych prac lutowniczych SMD. Dzięki wyjątkowej zdolności zwilżania powierzchni miedzianych (Cu) oraz cynowo-ołowiowych (PbSn), produkt zapewnia niezawodne połączenia i doskonałą jakość lutów. Opracowany na bazie średnioaktywnego roztworu kałafoniowego, nie wymaga czyszczenia po użyciu, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów elektroniki.

Cechy produktu:

- średnio aktywna formuła,
- szybkie działanie,
- wysoka skuteczność,
- doskonała zdolność zwilżania powierzchni,
- zgodność z normą J-STD-004 ROLO,
- No Clean - brak konieczności zmywania pozostałości po lutowaniu.

Zastosowanie:

- lutowanie komponentów SMD,
- pobielanie końcówek przewodów,
- lutowanie pasywowanych powierzchni,
- montaż mieszany w elektronice profesjonalnej i użytkowej,
- zwilżanie powierzchni miedzianych (Cu) oraz cynowo-ołowiowych (PbSn).



Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Bursztynowa ciecz
Gęstość w 20°C	0,80 g/cm³
Lepkość w 20°C	15,8 cP
Liczba kwasowa	18,5 mg KOH/g
pH (5% roztwór wodny)	3,4
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszcza się
Temperatura wrzenia	82°C
Temperatura samozapłonu	425°C
Temperatura zapłonu	Tygła zamkniętego: 12°C
Zawartość substancji stałych	4%
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Topnik RF800 jest chemicznie neutralny wobec większości materiałów elektronicznych i metalowych, co pozwala na bezpieczne stosowanie w szerokim zakresie zastosowań. Jego formuła minimalizuje ryzyko korozji i zapewnia trwałość lutów.

Metody aplikacji	
Aplikator	Tak
Butelka	Tak
Pędzelek	Tak
Pianą topnika	Tak
Natrysk topnikiem	Tak
Zanurzenie w topniku	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia lutowana jest czysta. Nanieś topnik na miejsce lutowania. Przystąp do procesu lutowania, stosując odpowiednią temperaturę grotu. Po zakończeniu lutowania nie ma potrzeby czyszczenia — formuła No Clean zapewnia czyste i trwałe połączenia.

W przypadku przerw w pracy urządzeń podających topnik zalecamy okresowe przepłukanie układu za pomocą Zmywacza PCB alkoholowego. Preparat skuteczniej niż alkohol izopropylowy usuwa zaschnięte pozostałości topnika No Clean, dzięki czemu zapobiega zatykaniu dysz i utrzymuje stabilność procesu.

Opakowanie

Butelka z aplikatorem	15 ml (ART.AGT-042) - 20 szt.*
Butelka z pędzelkiem	50 ml (ART.AGT-248) - 8 szt.* 100 ml (ART.AGT-109) - 8 szt.*
Butelka	1 l (ART.AGT-043) - 4 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 5°C do 30°C (41°F do 86°F). Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.

